

# Lasertec News 21

株 主 通 信 第 5 7 期 (2018年7月1日~2019年6月30日)

今後成長が見込まれる半導体の  
新規分野や先端分野に注力し、  
レーザーテックの躍進につなげます

Lasertec

証券コード6920



2019年6月期(当期)は、売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高を更新しました。これで3期連続の記録更新になります。EUVをはじめとする半導体産業の技術革新の波を捉え、新中期経営計画フェーズⅢは幸先のよいスタートが切れました。

代表取締役社長  
岡林 理

**Q1** シリコンサイクルが調整局面に入ったといわれますが、当期の業績に影響はありましたか。

**A1** 景気変動の影響を受けにくい先端分野や成長市場にフォーカスすることで、売上、利益ともに過去最高を更新することができました。

シリコンサイクルに大きな影響を及ぼすメモリー市場では、DRAMやNANDと呼ばれるメモリーの需給バランス悪化や価格下落により、設備投資が抑えられました。

しかし半導体にはさまざまな用途があり、多様な種類のデバイスが生産されています。先端ロジックやパワー半導体(SiC)、CMOSイメージセンサへの投資は、当期に

においても順調に行われました。特に大手ファウンドリは回路線幅7nm、5nmノードの先端ロジック向け設備投資を積極的に行い、次世代EUVリソグラフィ\*技術の量産適用が初めて開始されようとしています。当社は、この技術革新を大きなチャンスと捉え、EUVに対応した検査装置を積極的に開発し市場に投入してきました。その中でもEUVマスク欠陥検査装置MATRICS X8ULTRAは、当期の受注および売上に大きく貢献しました。

当期の業績は、売上高287億69百万円(前連結会計年度比35.4%増)、営業利益79億41百万円(同39.7%増)、

経常利益78億34百万円(同37.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益59億33百万円(同35.9%増)となりました。

受注面では、前述のMATRICS X8ULTRAに加え、EUVマスクブランクス\*欠陥検査/レビュー装置ABICS E120の受注が大きく伸び、受注高444億49百万円(同3.7%増)、期末受注残高555億60百万円(同39.3%増)を達成しました。

※本誌7ページをご参照ください。

**Q2** いよいよ新中期経営計画フェーズⅢが開始されました。初年度の達成状況はいかがでしたか。

**A2** フェーズⅢの目標である競争力の強化や新規事業を大きく売上に結びつける点において大きな成果があったと考えます。

マスク欠陥検査装置MATRICS X8ULTRAは、1台で既存のフォトマスクも次世代のEUVマスクも両方検査

できるという、他社には無い機能を持っています。これは、先端ラインで既存のフォトマスクを中心にしつつも、

## 連結業績ハイライト



\* 親会社株主に帰属する当期純利益

少数のEUVマスクの採用を開始した半導体メーカーにとって大変貴重で便利な機能です。回路線幅7nmから5nmノードという最先端のマスクを検査できる基本性能を持ち、かつ1台で既存のフォトマスクと次世代のEUVマスクの両方を検査できる機能を備えていることが、お客さまから大変ご好評をいただき、半導体マスク検査装置という当社のコアビジネスにおいてさらに強い競争ポジションを確立するとともに、EUVマスク

検査という新規市場で高いシェアを獲得できました。MATRICS X8ULTRAは、EUVの量産開始初年度から大きな売上を達成し、当社の中でも大成功した装置になりました。

そして、新規事業であるSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICA88も、高い競争力を持ち着実にシェアを上げるとともに売上を増加させることができました。

### Q3 新中期経営計画フェーズⅢの今後の展望を教えてください。

**A3** フェーズⅢの期間では、フェーズⅡまでに種まきをしたEUV関連やウェハ検査関連の製品が収穫期に入ります。コアビジネスを成長させるとともに、新規ビジネスの収穫を確実なものにして、当社の躍進につなげていきたいと考えています。

半導体産業は、周期的な景気の波がありながらも、中長期的には成長を続けていくと見込んでいます。我々の生活を便利にしてくれるAI(人工知能)や5G(第5世代移動通信システム)、ADAS(先進運転支援システム)などの新技術の多くは、高性能な半導体を大量に必要とするからです。

また半導体産業は、半導体の高速化、低消費電力化、高集積化と低コスト化を同時に推し進めるために、微細化\*や3次元化をはじめデバイス構造や製造プロセスを常に進化させていきます。この進化の過程に、大きな

※本誌7ページをご参照ください。

ビジネスチャンスがあります。この成長する半導体市場で、さらに伸びていく新規分野や先端分野に注力することで、市場平均を上回る、より大きな成長の機会があると考えています。

当社は、革新的な半導体製造技術であるEUVの分野で、当社の強みである先進の光学技術や素早い製品開発力などを生かすことで、飛躍的な成長へとつなげてまいります。世界初のEUV光源を用いたEUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS E120は、当社の既存製品と比べて数倍の価格帯で販売される極めて高価

な製品で、いよいよ今期（2020年6月期）より売上・利益への貢献が見込まれます。また、マスク欠陥検査装置 MATRICS X8ULTRAも引き続き好調な受注と売上が

見込まれており、EUVマスク裏面検査/クリーニング装置 BASICシリーズと合わせて、当社の業績を力強く牽引していくでしょう。

### 新中期経営計画

2009年7月から2021年6月までの計12年間で、3年ごとにフェーズⅠからフェーズⅢまで4つのフェーズに分け、それぞれに注力すべき目標を掲げた経営計画。今期はフェーズⅢの2年目。

### 最後に株主さまへメッセージをお願いいたします。

おかげさまで3期連続で、売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高を更新することができました。今期は、これまでの活動を結果に結びつけてさらに大きく業績を伸ばすことで、株主さまのご期待に応える所存です。

レーザーテックは、世界中のお客さまのご要望にお応えできる製品を開発し、お客さまに貢献することを通じて、グローバル企業として企業価値を高めてまいります。株主の皆さまにおかれましては、今後とも、一層のご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。



# レーザーテックのコアビジネスを担う主力製品 MATRICSシリーズ 進化の軌跡

マスク欠陥検査装置\*1MATRICSシリーズは今年1月、2006年の発売から累計出荷数100台を達成いたしました。レーザーテックのコアビジネスを担う本製品の進化の軌跡をご紹介します。

1976年、レーザーテックは世界ではじめて「LSIフォトマスク欠陥検査装置（Die to Die機能\*2搭載）」を発売しました。1980年代には高い市場シェアを占めていましたが、Die to Die機能に加えてDie to Database機能\*2を搭載した他社検査装置にマスク製作工場でのシェアを次第に奪われ、2005年には販売台数が大幅に落ち込みました。

そのような状況の中、Die to Database機能が不要な半導体製造工場でのマスク上の異物管理用途に特化し、高性能と低コストを両立することで、シェアを大きく巻き返すことに成功したのが「マスク欠陥検査装置 MATRICSシリーズ」です。X600、X700、X810シリーズと着実に性能・機能を向上させ、お客さまとの強固な関係を構築することで売上を継続的に伸ばしてきました。これからも開発スピードをさらに速め、開発力、営業力、サポート力、コスト対応力のすべてを強化し、業界標準機となるべくシェア拡大を目指してまいります。

**MATRICSシリーズの変遷**  
Mask Transmission/Reflection  
Image Comparison System

発表年

デザインノード

2006年11月

~65nm



**MATRICS X600シリーズ**

新世代フォトマスク欠陥検査装置初代機。プラットフォームを一新するとともに、最先端の技術を結集し、高い検出感度を達成。ヘイズ検査機能を搭載。

開発力、営業力、サポート力、コスト対応力のすべてを強化。  
さらなる市場シェア拡大を目指します。

※1 マスク欠陥検査装置：

半導体デバイスを製造するときに用いられるマスク\*3上の微小異物や欠陥を検出する装置。半導体の微細化に伴い、マスクパターンもより高精細になっており、マスク上の微細な欠陥や、ヘイズと呼ばれる成長性異物は半導体の良品率に大きく影響するため、検査装置の重要性が高まっている

※2 比較検査方式の種類：

- Die to Die 機能：マスク上に配置されている隣接するチップ(ダイ)とチップ(ダイ)を比較して欠陥を検出する方法
- Die to Database 機能：マスク上に配置されているチップ(ダイ)とパターンの設計データを比較して欠陥を検出する方法
- Mask to Mask 機能：マスク全体の画像を保存し、マスクを使用する前と後で比較して欠陥を検出する方法

※3 マスク(フォトマスク)：

マスクブランク스에回路パターンを形成したもので、リソグラフィで回路パターンを転写させる際の原版となる

本誌7ページも併せてご参照ください。

2009年9月

~28nm



**MATRICS X700 シリーズ**

独自開発した短波長レーザーを採用し、大幅な感度向上と安定性を実現。マスク検査市場における復活を決定づけ、業績回復に導いた原動力。

2012年11月

20nm/16nm ~ 10nm



**MATRICS X810 シリーズ**

プラットフォームを刷新し、高出力レーザー、高性能のレンズを搭載し、大幅な感度向上を達成。大手半導体製造受託会社の工場で標準機として採用される。

2018年4月

7nm ~ 5nm



**MATRICS X8ULTRA シリーズ**

さらなる小画素化および照明の工夫で、高い検出感度を達成。従来の最先端マスクおよびEUVマスクの両方に対応。Mask to Mask 機能\*2を搭載。

2019年1月

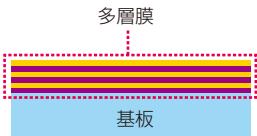
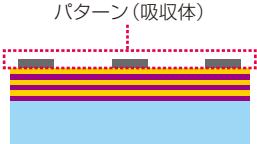
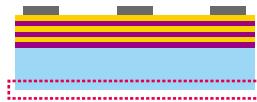
累計出荷数100台達成。業界標準機を目指し市場シェアを拡大中。

## 新規事業 EUVマスク関連装置

EUV (Extreme Ultraviolet) リソグラフィ<sup>\*1</sup>とは、極端紫外線といわれる非常に短い波長(13.5 nm)の光を用いるリソグラフィ技術で、従来のリソグラフィ(波長193nm)に比べ、より微細なパターンを形成できる次世代の技術です。

半導体デバイスは、スマートフォンやパソコンなどの

身近にある電子機器に使用され、さらなる小型化・高性能化のため微細化<sup>\*2</sup>が進んでおり、そのための技術としてEUVリソグラフィの実用化が始まりつつあります。当社ではEUVリソグラフィに対応した製品需要を見込み、すでに3製品をラインアップし、積極的な営業活動を推進しています。

	EUVマスクブランクス <sup>*3</sup> 欠陥検査/ レビュー装置ABICS E120	マスク欠陥検査装置 MATRICS X8ULTRAシリーズ	EUVマスク裏面検査/ クリーニング装置BASICシリーズ
検査対象	EUVマスクブランクスを検査  	EUVマスクのパターン面(表面)を検査  	EUVマスクの裏面を検査  
特長	EUVリソグラフィ装置と同波長(13.5nm)を採用した世界で唯一の検査装置  	従来の最先端フォトマスクおよびEUVマスクの両方の検査が可能  	検査に加え、異物の高さ測定および異物を除去(クリーニング)  

※1 リソグラフィ：半導体デバイスの微細で複雑な回路パターンをウエハ上に転写する技術。露光とも呼ばれる

※2 微細化：半導体回路の寸法を狭めること。寸法を狭めるほど半導体デバイスの性能が高くなる

※3 マスクブランクス：フォトマスク作成用の材料であり、回路パターンが描かれる前の基板

## MAGICSシリーズ M9651が 「半導体・オブ・ザ・イヤー2019」でグランプリを受賞

電子デバイス産業新聞が主催する「半導体・オブ・ザ・イヤー2019」半導体製造装置部門において、「マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 MAGICSシリーズ M9650/M9651」が昨年の「EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS E120」に続き、2年連続のグランプリを受賞しました。

本賞は最新のエレクトロニクス製品の開発において最も貢献した製品を表彰するもので、2018年4月～2019年3月までに発表された製品・技術（バージョンアップ等を含む）を選考対象とし「開発の斬新性、量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性」などを基準に、記者の投票により3部門7製品が選出されています。

M9650/M9651は、既存の光リソグラフィ向けマスクブランクスのみならず、次世代リソグラフィ技術で使用されるEUVマスクブランクの母材となるガラス基板や、吸収層の極小欠陥を検出する、高品質マスクブランクス製造に欠かせない

検査装置です。今回のグランプリ受賞では「5nm以降という最先端分野に向けた装置開発」や、「次世代半導体製造プロセス（EUV）を構築するために必要な装置」などの点が評価されました。

これからも半導体業界の微細化に伴うニーズを捉え、タイムリーにソリューションを提案し、最先端の光応用技術を用いて製品開発に一層力を入れてまいります。



受賞式 2019年6月5日

# 2019年6月期(第57期)の連結決算のご報告

## 連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2019年6月30日)	前連結会計年度 (2018年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2019年6月30日)	前連結会計年度 (2018年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	39,841	29,387	流動負債	18,433	10,779
			固定負債	514	288
			負債合計	18,948	11,068
固定資産	10,214	8,733	純資産の部		
			株主資本	31,019	26,799
			① 純資産合計	31,107	27,053
資産合計	50,055	38,121	負債純資産合計	50,055	38,121

## 連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2018年7月1日 至2019年6月30日)	前連結会計年度 (自2017年7月1日 至2018年6月30日)
② 売上高	28,769	21,252
売上原価	12,853	9,251
売上総利益	15,916	12,001
販売費及び一般管理費	7,975	6,315
② 営業利益	7,941	5,685
② 経常利益	7,834	5,706
② 親会社株主に帰属する当期純利益	5,933	4,366

## 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2018年7月1日 至2019年6月30日)	前連結会計年度 (自2017年7月1日 至2018年6月30日)
③ 営業活動による キャッシュ・フロー	5,800	2,916
投資活動による キャッシュ・フロー	△994	△684
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,715	△1,805
現金及び現金同等物の 期首残高	10,107	9,736
現金及び現金同等物の 期末残高	13,120	10,107

## 決算のポイント

### ① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は、311億7百万円となりました。自己資本比率62.1%、ROE(自己資本当期純利益率)20.4%、ROA(総資産当期純利益率)13.5%となりました。

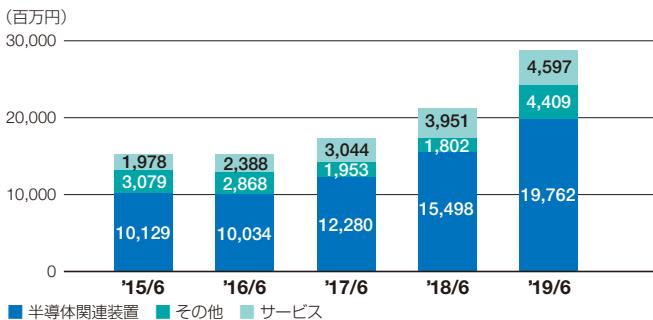
### ② 売上高/利益

高水準な利益率を維持しつつ、売上高・利益は過去最高額を3年連続で更新しました。300億円に迫る売上は半導体マスク欠陥検査装置が牽引。また、積極的な研究開発投資(10ページ参照)を行いながらも、営業利益は前連結会計年度比22億55百万円増となりました。

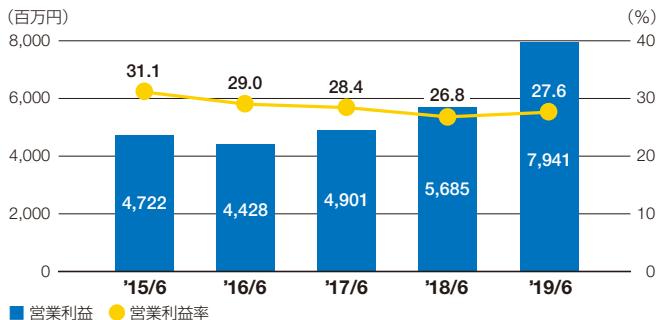
### ③ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出要因を上回りました。

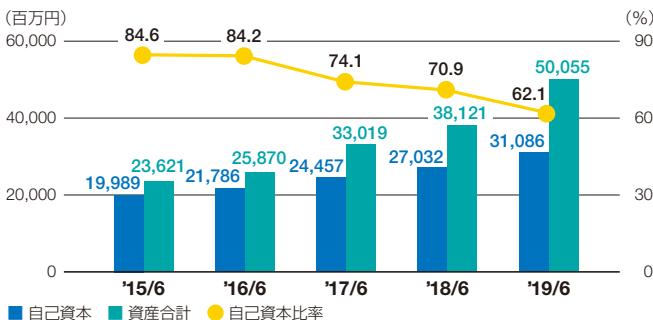
## 製品別売上高



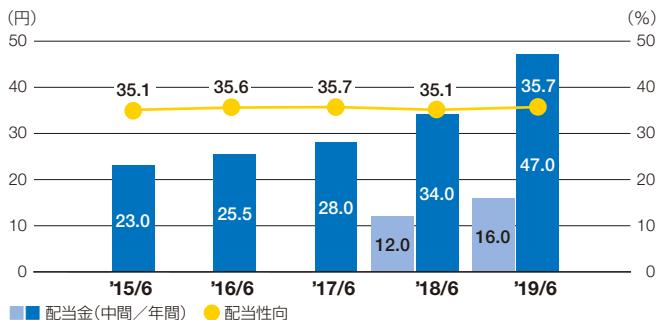
## 営業利益・営業利益率



## 自己資本・資産合計・自己資本比率

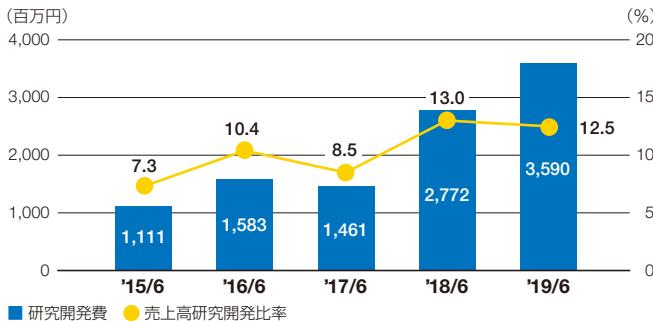


## 1株当たり配当金・配当性向

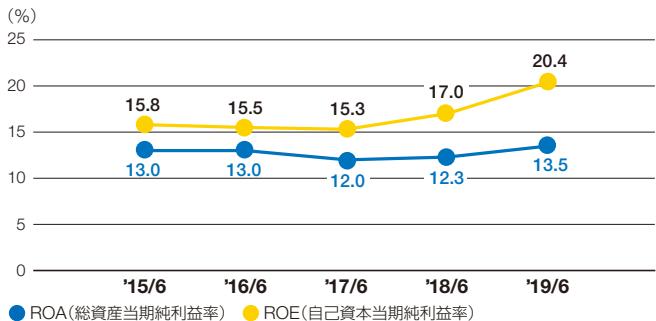


※2017年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、上記の金額を算定しています。また、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、2017年6月期配当性向は、遡及修正後の数値を用いて算出しています。

## 研究開発費・売上高研究開発比率



## ROA・ROE



※2018年6月期の会計方針の変更に伴い、2017年6月期の決算数字を遡及適用し変更しています。

# 会社概要 (2019年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 375名 単体 254名
お問い合わせ先	045-478-7127 (経営企画室)

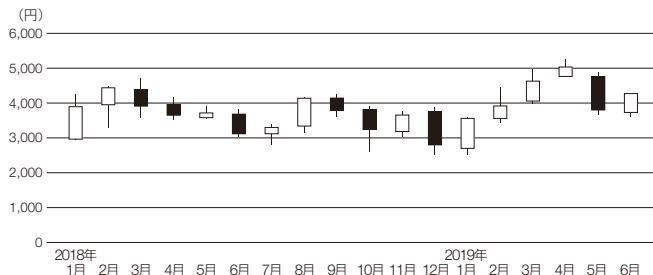
# 株式情報 (2019年6月30日現在)

## 株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部
発行済株式総数	47,143,200株
株主総数	6,599名
大株主一覧	
	持株数(千株) 持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,305 5.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,018 4.47
内山 靖子	2,003 4.44
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS	1,855 4.11
内山 洋	1,741 3.86
株式会社三菱UFJ銀行	1,504 3.33
内山 秀	1,394 3.09
前田 せつ子	1,293 2.86
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB	981 2.17
UCHIYAMA HOLDINGS 株式会社	807 1.79

(注)1. 当社は、自己株式を2,054,196株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 株価の推移



## 役員 (2019年9月27日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 梶川 信宏 海老原 稔 下山 隆之
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 塚崎 健明
常務取締役 内山 秀	監査役 齋藤 侑二 石黒 美幸
取締役 森泉 幸一 関 寛和	

## 株主メモ

事業年度 7月1日から翌年6月30日まで  
定時株主総会 毎年9月  
基準日 毎年6月30日 (なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数 100株  
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
同連絡先 東京府都中市日鋼町1-1  
電話 0120-232-711 (通話料無料)  
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>  
ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いさせていただきます。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

## 当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp>

Webサイト「個人投資家の皆さまへ」にも詳細なIR情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

